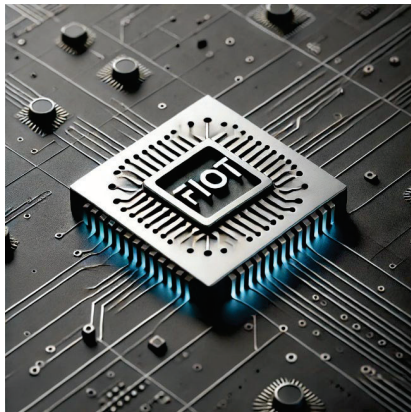


# FIoT コンソーシアム 新世代パッケージング分科会 および開発拠点の紹介



国立研究開発法人 産業技術総合研究所  
センシングシステム研究センター

**竹井 裕介**

yusuke-takei@aist.go.jp

ともに挑む。つぎを創る。

## 新世代パッケージング分科会

### ねらい・目的

- 半導体後工程・フレキシブル機材・印刷・配線・実装分野の技術開発動向を調査・共有し、課題の抽出、技術的解決策の議論を重ね、参加メンバーの開発競争力強化とメンバー間の連携強化を図る。
- 参加メンバー間での新たな連携プロジェクトの創出、公的支援資金の獲得、事業化を目指した活動を行う。



ともに挑む。つぎを創る。

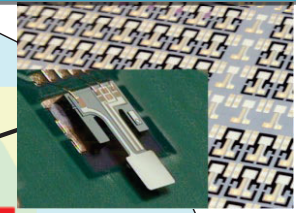
# 産総研つくば東地区

R5補正予算事業「新世代ハイブリッドパッケージ開発拠点」により新CRを整備 280m<sup>2</sup>

圧電MEMS開発設備 100m<sup>2</sup>



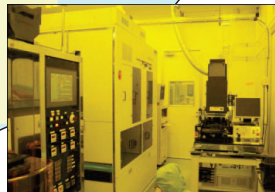
4インチ “MEMS試作ライン” 350m<sup>2</sup>



後工程設備 100m<sup>2</sup>



後工程・検査設備 200m<sup>2</sup>



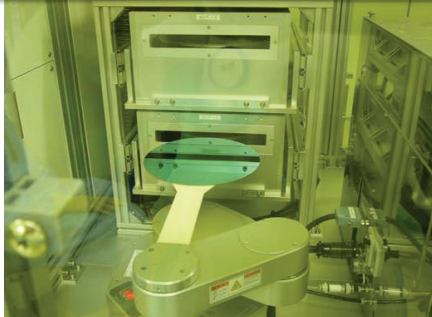
8インチ “MEMS試作ライン” 350m<sup>2</sup>

ともに挑む。つぎを創る。

# 産総研つくば東地区

圧電MEMSデバイス試作・評価装置

Automated sol-gel for 8-inch PZT / ScAlN wafer



8-inch process line



蛍光X線分析装置 (XRF)



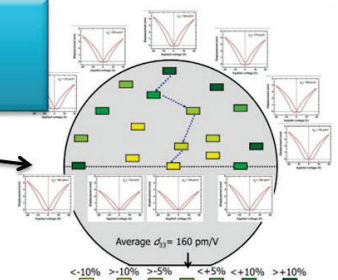
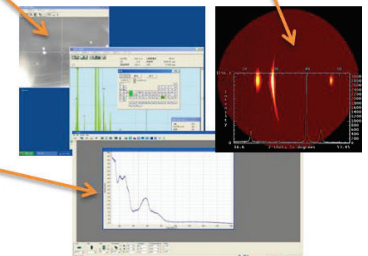
Raman分光装置



Piezoelectric property



X線回折装置 (XRD)



ともに挑む。つぎを創る。

## 産総研保有施設一覧（つくば東地区）

<b>洗浄</b>									
<b>成膜</b>									
<b>リソグラフィ</b>									
<b>エッチング</b>									
<b>接合加工</b>									
<b>加工評価</b>									

ともに挑む。つぎを創る。

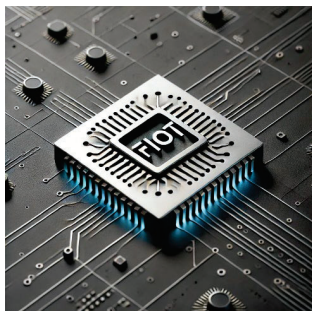
## 産総研保有施設一覧（九州センター）

<b>洗浄</b>				<b>エッチング</b>			
<b>成膜</b>				<b>評価</b>			
<b>リソグラフィ</b>							
<b>実装</b>							



ともに挑む。つぎを創る。

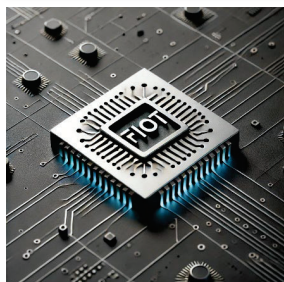
# 産総研 FIoTコンソーシアム 第1回 新世代パッケージング分科会 2024/8/29(木)



- 14:00~14:10 開会の挨拶、新世代パッケージング分科会の趣旨説明
- 14:10~15:00 講演「熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構の取り組みと FIoT 新世代パッケージングへの期待」 熊本大学 青柳昌宏 卓越教授
- 15:00~15:10 休憩
- 15:10~15:40 IEEE MEMS 2024 動向調査報告
- 15:40~16:10 IEEE ECTC 2024 動向調査報告
- 16:10~16:20 次回案内、事務連絡等
- 16:30~17:00 (現地参加の方)つくば事業所東地区 見学

ともに挑む。つぎを創る。

## 第2回 新世代パッケージング分科会ご案内



### 2024/11~12月開催予定

産総研 FIoTコンソーシアム <https://www.ssrc-fiot.jp/>

コンソ事務局 : [fiot-official-ml@aist.go.jp](mailto:fiot-official-ml@aist.go.jp)

新世代パッケージング分科会 : [yusuke-takei@aist.go.jp](mailto:yusuke-takei@aist.go.jp)



産総研つくば東地区MEMS微細加工拠点の紹介

<https://www.youtube.com/watch?v=HFVikJjb0P4&list=PLfaKrsaqjR-rMWGHt2JSB31fSjX50nvY>

ともに挑む。つぎを創る。